nexes

Investor Presentation

Semiconductor | IT materials | Energy



2026.10

Disclaimer

본 자료는 투자자에게 네패스의 영업전망, 경영목표 등 정보제공을 목적으로 작성되었으며 임의 반출, 복사 또는 상업적 이용을 위한 재배포는 금지됨을 알려 드리는 바입니다.

본 자료에 포함된 예측정보는 과거가 아닌 미래의 사건에 관련된 사항이며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 회사가 통제할 수 없는 시장 환경의 변동 및 위험 등의 불확실성으로 인해 회사의 실제 영업실적 결과와 일치하지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

마지막으로 본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며, 당사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

Part 01

OVERVIEW

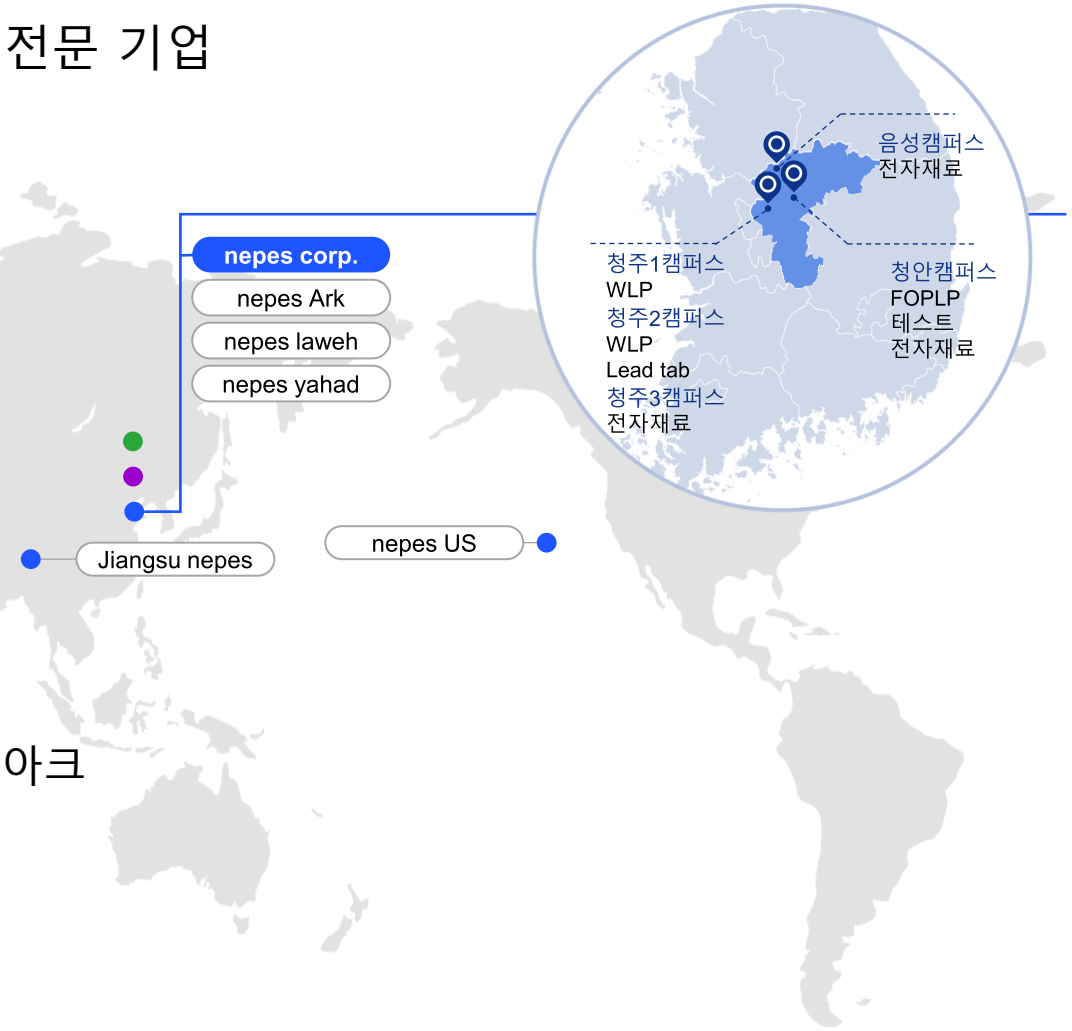
Introduction

네패스는 지속가능한 성장을 실현하는 첨단 반도체 패키징 전문 기업

‘네패스’는 ‘영원한 생명(Eternal Life) ' 을 뜻하는 히브리어로 강인한 생명력과 지속 성장을 지향하는 회사의 비전을 상징합니다.

OVERVIEW

회사명	네패스	**대표이사**	이병구, 이창우
설립일	1990/12/27(상장일: 1999/12/14)	**상장주식수**	23,059,202
주요 사업	첨단 반도체 패키징 서비스		
국내 사업장	• 반 도 체: 충북(청주, 괴산) • 전자재료: 충북(음성, 청주, 괴산), 온산 • 이차전지: 충북(청주, 괴산)		



지속 성장을 꿈꾸는 시스템 반도체 테스트 솔루션 전문 기업 네패스아크

아크의 어원 (Noah’s Ark, 노아의 방주)

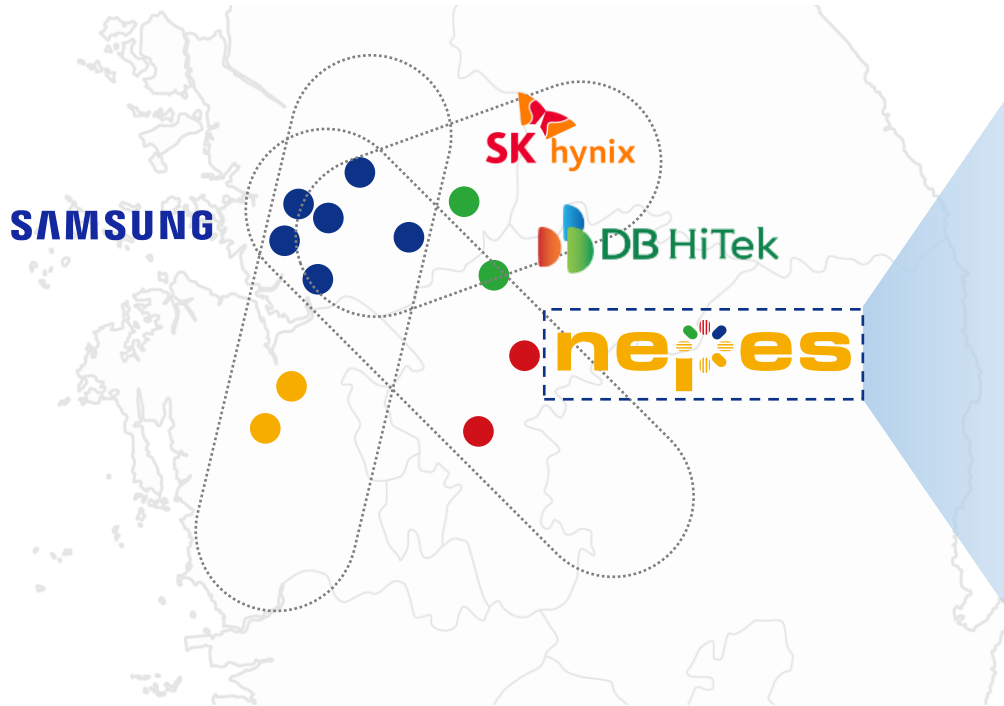
검증과 선별의 기능을 담당하는 테스트 솔루션 전문 기업을 의미

OVERVIEW

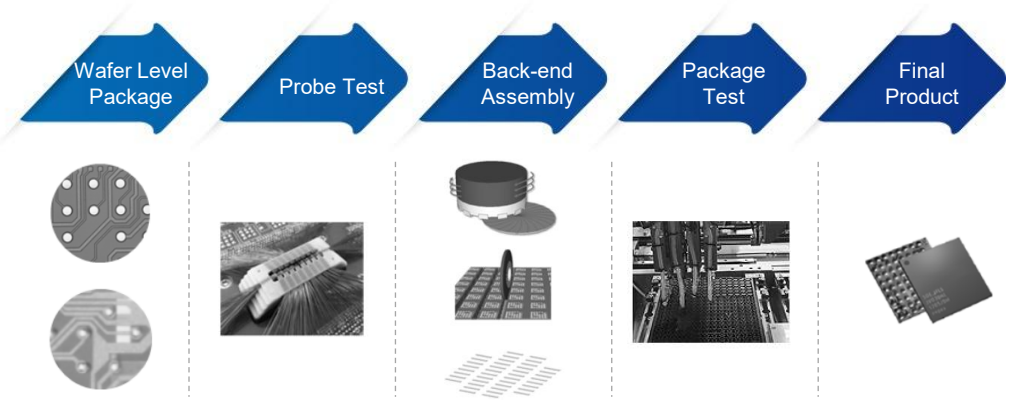
회사명	네패스 아크	**대표이사**	이병구, 이창우
설립일	2019.04.01(상장일: 2020/11/17)	**상장주식수**	12,184,045주

Core back-end foundry for K-semiconductor belt

K-반도체 벨트



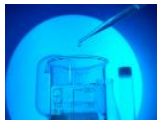
Back-end Foundry Turnkey Solution



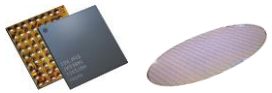


'K-반도체 전략 보고대회'
반도체 패키징 대표기업으로 참석

Chronology of Semiconductor



1992
전자재료 사업 시작
[음성]
디스플레이&반도체용 케미컬 양산



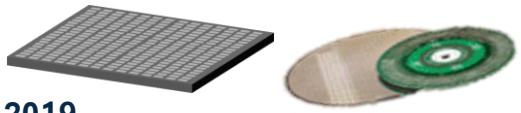
2000
반도체 사업 본격화
[오창]
시스템반도체 WLP&테스트 사업 진출



2015
Fan-out WLP 양산 시작



2017 nepes yahad
이차전지 사업 전환



2019
600mm FOPLP 양산 시작



2006
nepes Pte.
싱가포르 JV 설립



2009
[오창] WLP
제 2 양산 공장 준공



2019
테스트 사업 분사
nepes Ark



2019
[괴산 청안]
600mm FOPLP 팹 준공
nepes laweh

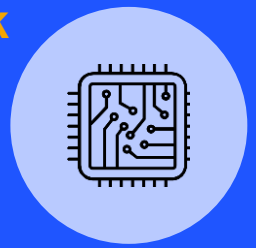


2023
[괴산 청안]
테스트 팹 / 케미컬 팹 준공

Business portfolio

첨단 패키징, 전자재료, 2차전지 부품 사업의 기술 역량을 기반으로 경쟁력 확보

nepes
nepes Ark



Semiconductor

저전력, 고성능,
모듈화(Integration) 패키징 기술

- Bumping
- WLP
- FOWLP/PLP
- SiP
- TEST

Smartphone, Automotive, AI Server

nepes



IT Materials

고순도, 균일 품질, 공정
신뢰성을 높이는 소재 기술

- Cu plating
- Photo Resist
- PSPI
- Stripper

Advanced packaging(WLP, HBM)

nepes (yahad)



Rechargeable battery

안정성, 고출력 기반의
ESS/EV/HEV 대응 기술

- Lead-tab
- TBA
- FRC

Automotive, Datacenter, Smart home

Part 02

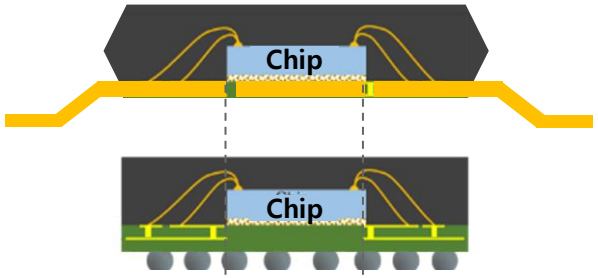
CORE COMPETENCE

Advanced Packaging Pure Player

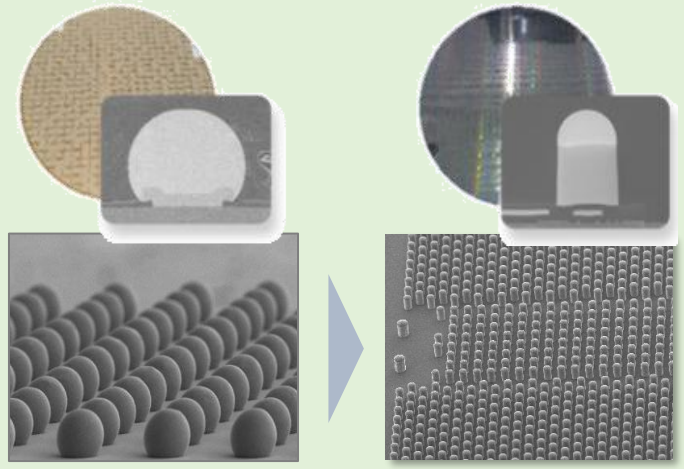
반도체 경쟁력 강화를 위한 핵심 기술 저전력, 고효율, 고집적

◆ **Conventional PKG**

- **QFP** (Quad Flat Package)
- **BGA** (Ball Grid Array)

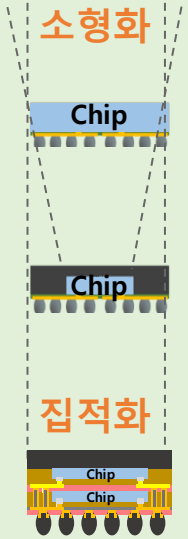


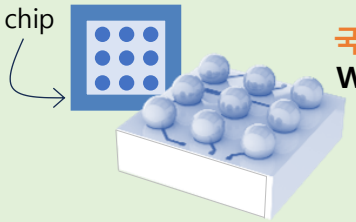
Copper Pillar Bump / RDL(재배선) / 이종집적



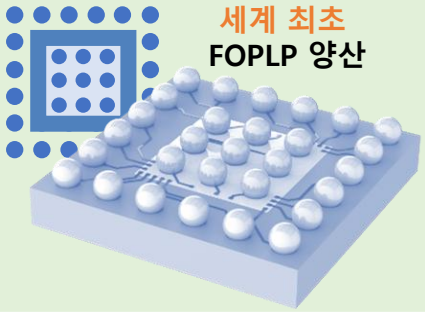
◆ **Advanced PKG**

- **FIWLP** (Fan-In Package: Wafer Level)
- **FOWLP/PLP** (Fan-Out Package: Wafer/Panel Level)
- **2.5D/3D** (Chiplet)

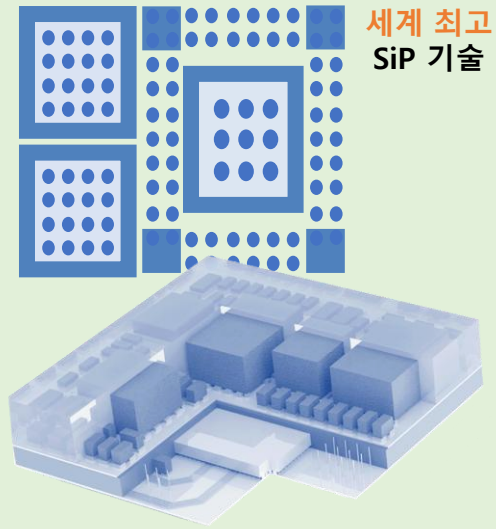




국내 최초
WLP 양산



세계 최초
FOPLP 양산

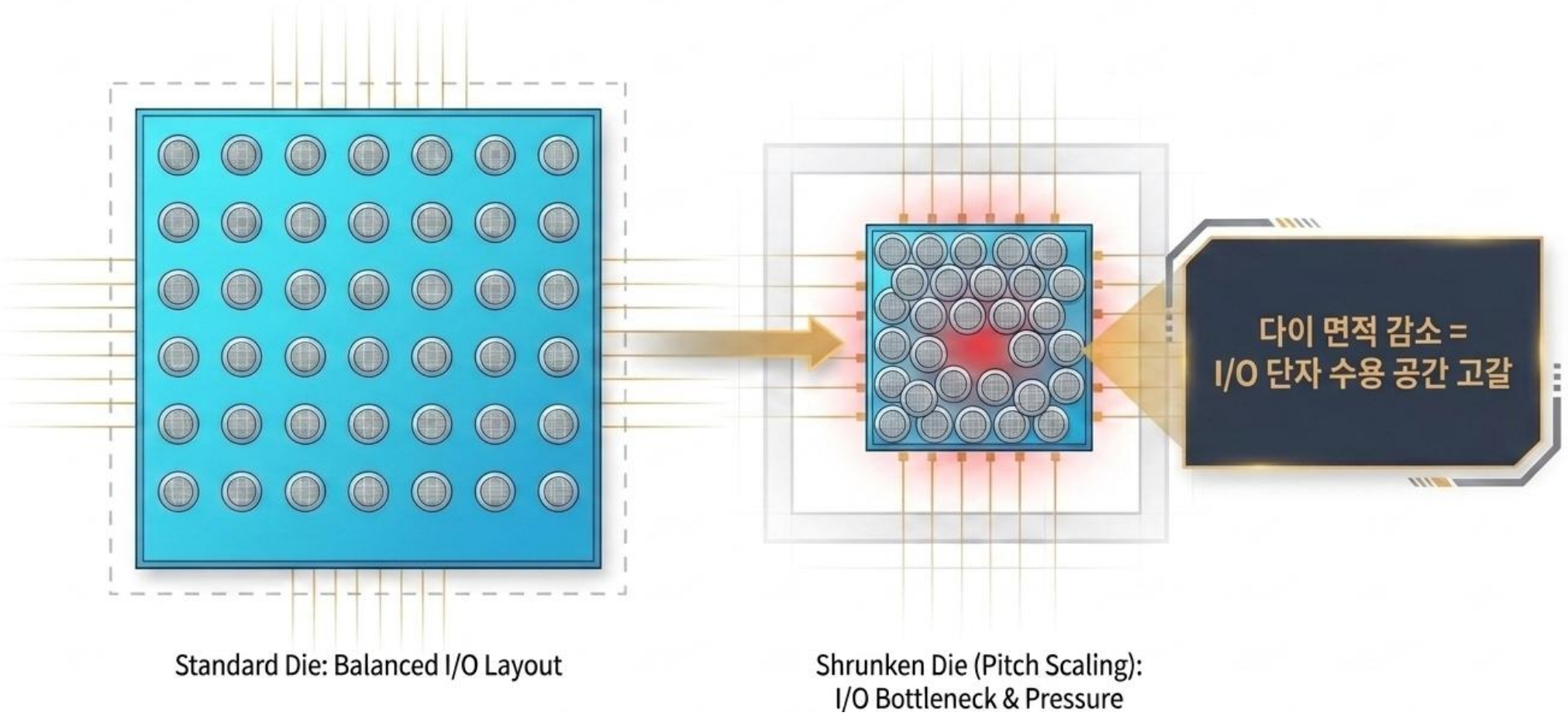


세계 최고
SiP 기술

Advanced Packaging (첨단 패키징의 중요성)

미세화가 초래하는 I/O 병목 현상

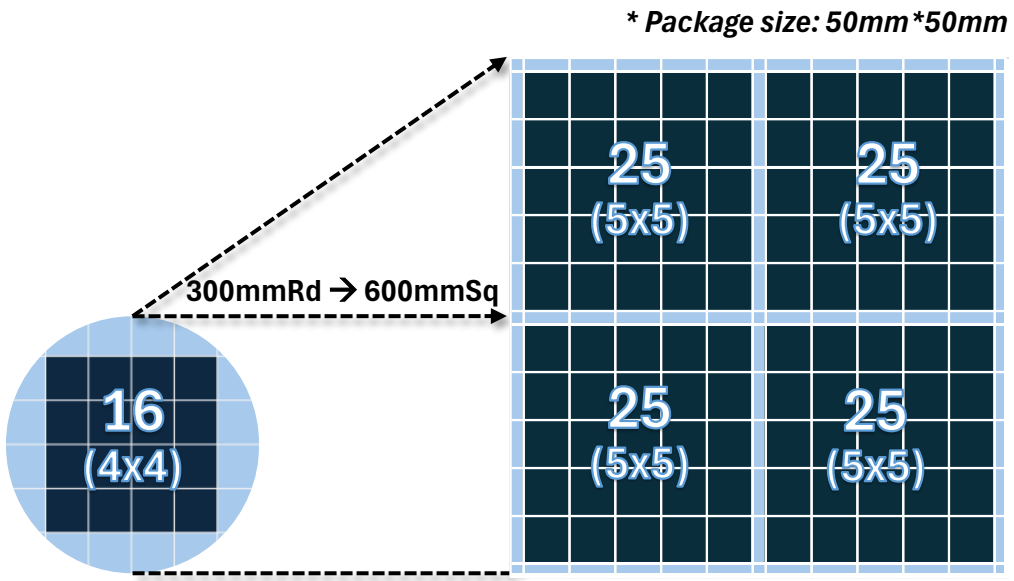
: 기존 Fan-In WLP는 다이 표면 안에서만 I/O 레이아웃을 소화해야 하는 물리적 제약 존재



PLP(Panel Level Package)

레티클의 급격한 증가로 인해 대형 패널 FOPLP 채택 가속화

Area Efficiency & Cost Optimization



300mm wafer

16 units

Production

X6.25

600*600mm PLP Panel

100 units

Production

3 Major Barriers to Market Entry

Technology	**Warpage, Die drift and large-area process uniformity**
CapEx	**High investment for PLP mass-production lines and advanced equipment**
Echo-system	**Limited supply chain readiness across equipment and materials**

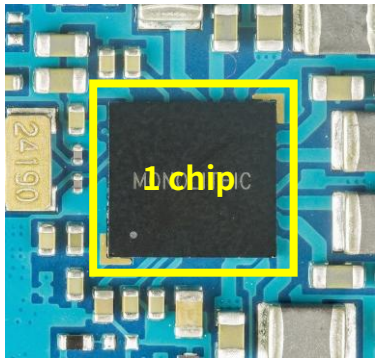
nepes	tsmc	ASE	Amkor Technology	PTI
600x600mm 세계최초 양산	310x310mm 510x515mm	300x310mm 600x620mm	650x650mm	510x515mm

PLP(Panel Level Package)

레티클의 급격한 증가로 인해 대형 패널 FOPLP 채택 가속화

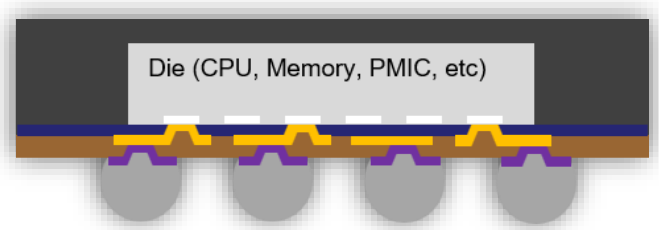
More Chips in One Package

From single function packages



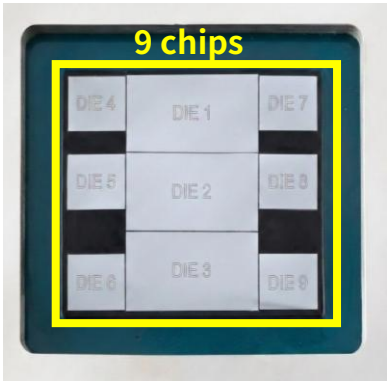
Traditional Single-Function Packages

Discrete, standalone components requiring significant board space and communication latency.



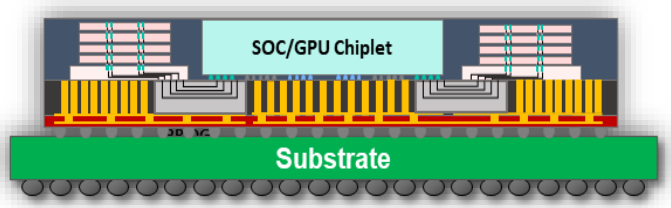
Panel Level Package is ultimate solution for AI

To heterogeneous chiplet packages



Heterogeneous Integration (HI)

Multiple modular chiplets co-packaged on a single high-density substrate for optimal speed, efficiency, and cost.



Part 03

MARKET & CUSTOMER

Semiconductor Industry Supply Chain

Fabless (IC Design)	Fab Foundry	OSATs(Outsourced Semiconductor Assembly & Test)	Module & Set

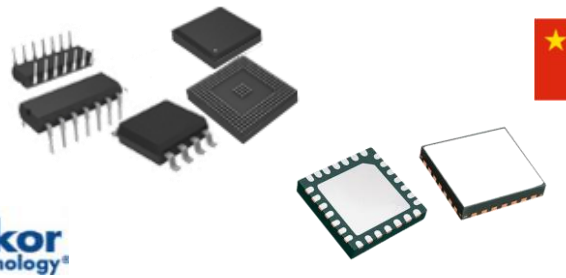
SAMSUNG
MPS
NXP freescale
QUALCOMM
Silicon Works
Silicon Mitus
MICROCHIP
SONY make.believe
CIRRUS LOGIC
SK hynix

tsmc
SMIC
世界先進 VIS
SAMSUNG
SK keyfoundry
DB HiTek

Front-end

Foundry
8", 12"

JCET
TF 通富微電
KYEC The Testing Industry Benchmark



Amkor Technology

nepes

Advanced Packaging & Test

Wafer Level Package
Test
Package SiP
T&R

Back-end Turn Key Solution

Continental
SAMSUNG
LG
TOYOTA
NVIDIA

Set





Module, Car, Phone

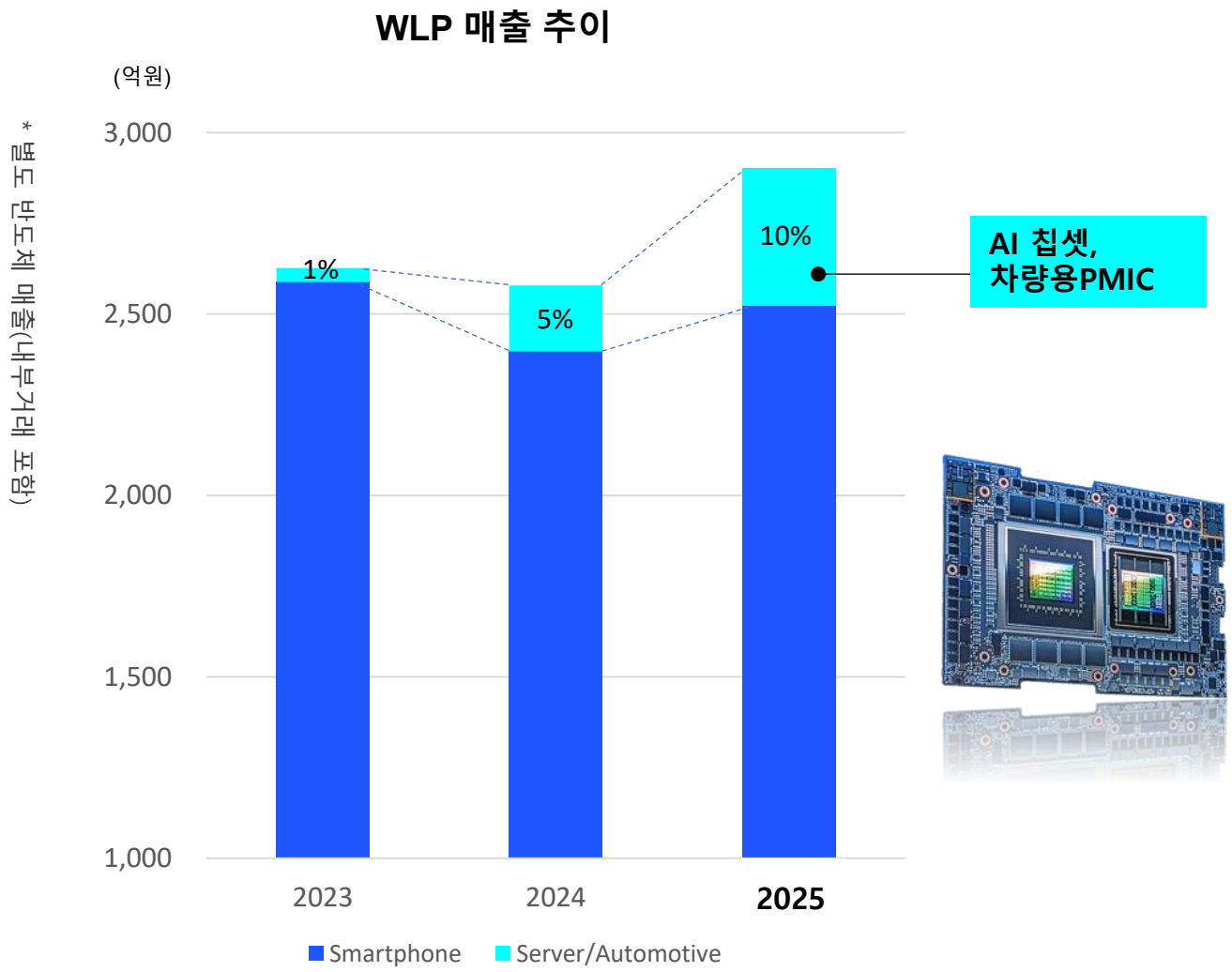




Part 04

BUSINESS OUTLOOK

Semiconductor-Wafer Level PKG



[전망]

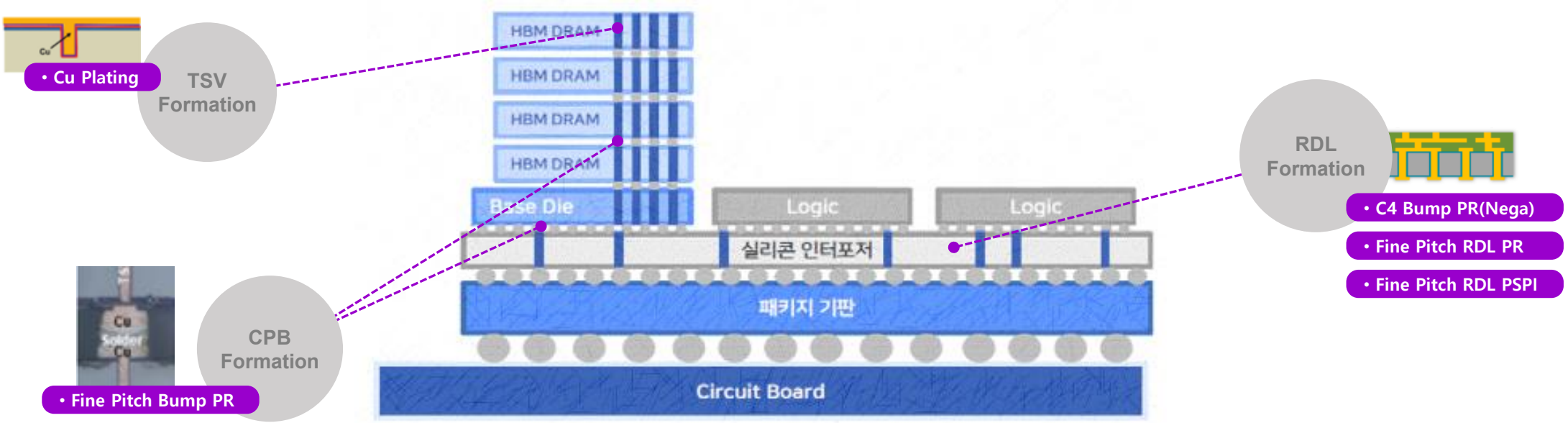
- AI 시장 확장에 따른 데이터센터, 자율주행 등 첨단패키징 기술 확대
- 국내 파운드리 시설 증설에 따른 지속적인 패키징 외주화 물량 확대
- 레거시(8") 생산시설 부족으로 공급부족 현상 지속

[전략]

- AI 서버, Automotive 등 고성장 응용처 수주 확대
- 고수익 공정 비중 확대에 따른 수익성 개선
- 12" CPB 증설 결정, 차세대 고사양 패키징 인프라 확보

IT Materials(전자재료)

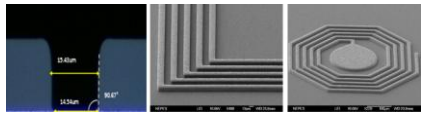
- 반도체 / 디스플레이 / 에너지 분야의 핵심 케미컬 소재 제조/판매(국내 Top tier 고객)
- High Purity Technology, 균일 품질 유지(Batch to batch) 역량으로 Advanced Package용 고성능 소재 Solution 제공



[2.5D Package 적용사례] source: e-best research

Product

- Cu 도금액, PSPI 절연막, Stripper
- Photo Resist, Developer
- Stripper, CNT 분산액



Applications

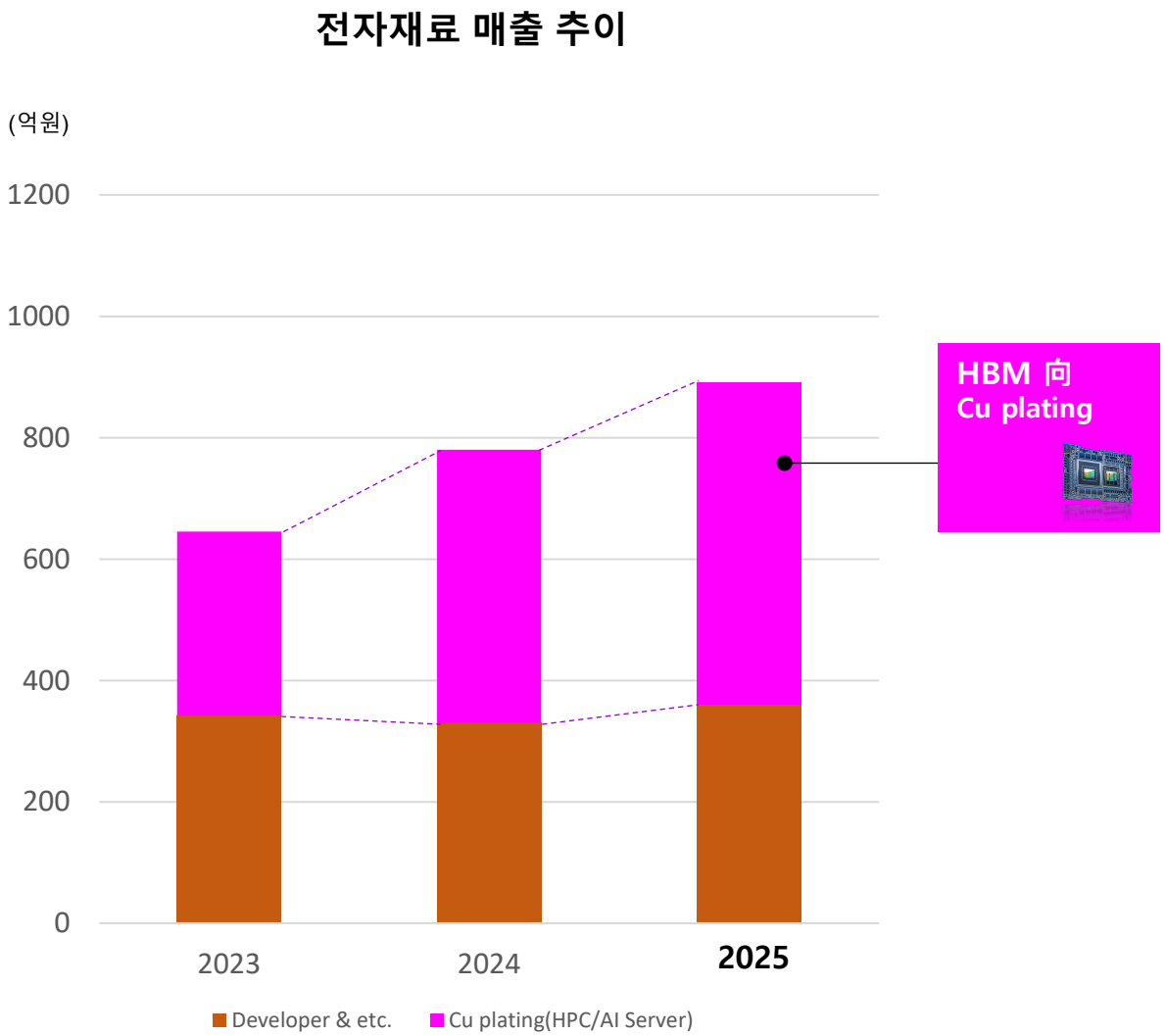
HBM, DDR5

System IC(AP, PMIC, DDI, etc.,)

OLED display



IT Materials(전자재료)



[전망]

- 국내 반도체 제조사들의 Cu 도금액 국산화 가속
- HBM4 양산 물량 증가에 따라 재료 수요 증가 전망
- Cu 도금액 성장률 CAGR +25% 전망

[전략]

- HBM向 고기능성 재료 수요 확대에 따른 구조적 성장
- 첨단 패키징과 동반 성장하는 수직계열화 포지션 유지
- 高수익 제품 비중 증가/제조 운영 효율화로 수익성 개선
- Cu 도금액 원재료 내재화를 통한 수익성 개선

Lead tab(Rechargeable battery)

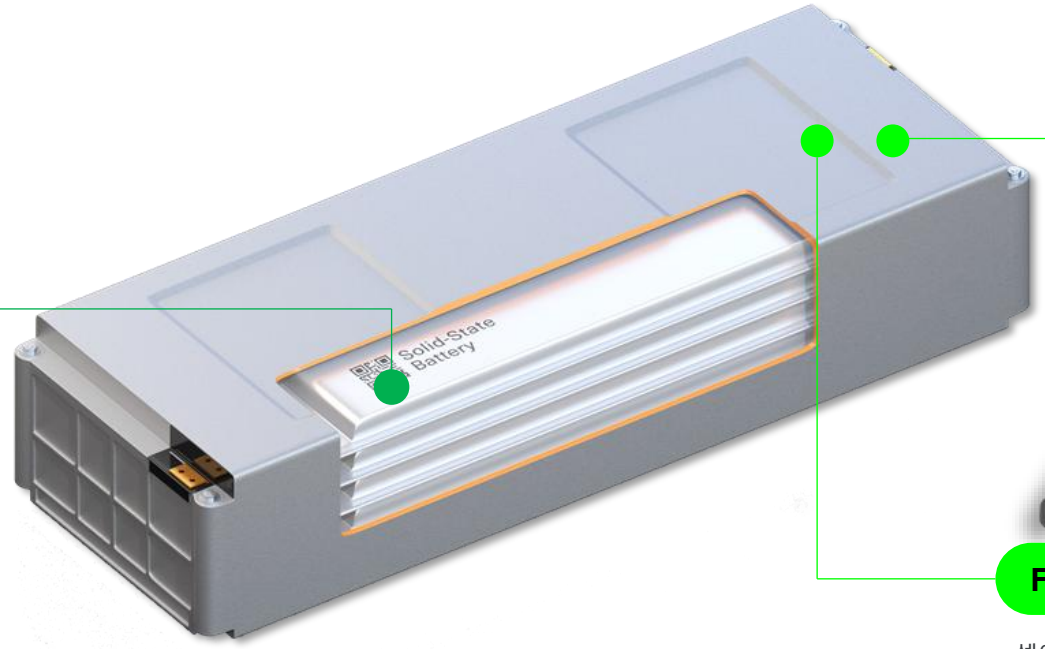
- **ESS/EV**에 탑재되는 파우치형 **2**차전지용 리드탭 제조·공급
- 전기차용 화재 지연 안전장치 부품 · 소재 개발 및 공급

Battery Module
Pouch Cell



Lead Tab

- 이차전지 외부로 전기를 입출력 시키는 전극 단자





TBA Thermal Barrier Assembly

- 파우치 배터리의 셀과 셀 사이에 부착되어 화재 진압 시간을 최소화하여 열 폭주로부터 보호



FRC Fire Retardant Capsule

- 셀에서 화재가 발생할 경우 실리카 장벽 생성으로 열 폭주 방지 및 지연

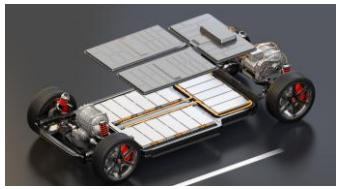
Service & Products

- Lead Tab
- Thermal barrier assembly
- LIB anode electrode



Applications

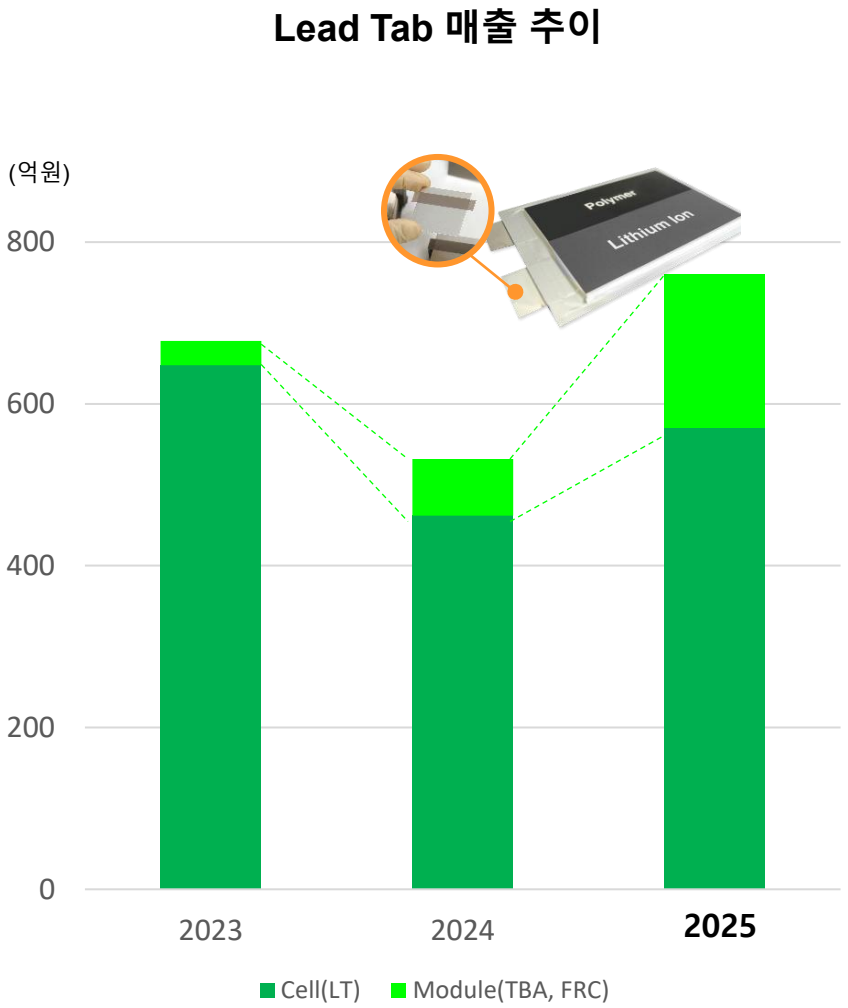
- EV/HEV
- ESS







Lead tab(Rechargeable battery)



[2026년 전망]

- 전기차용 Safety 부품 개발 요구 확대
- 화재지연 신제품 매출 확대 본격화

[시장]

- 일시적 EV성장세 둔화 및 배터리 가격 하락에 따른 수요 회복 모멘텀 상존

[현황·전략]

- 해외 고객사 양산 진입 등 고객 다양화 추진
- 화재지연 안전장치 등 신규 제품 양산 확대

Part 05

2Q26 Financial Performance

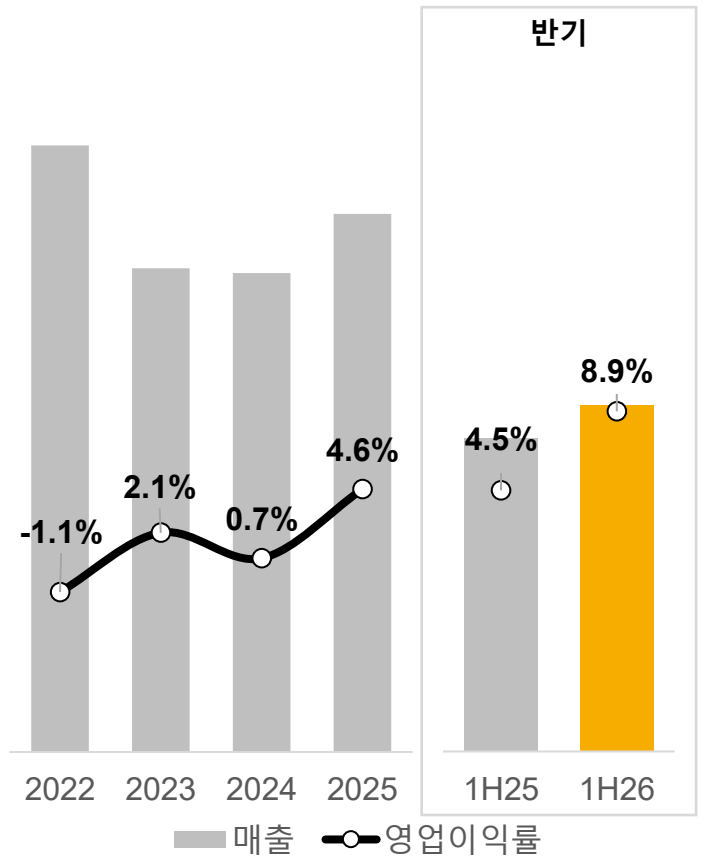
네패스 2Q26 실적(연결)

연결 손익

(단위 : 백만원)	2022	2023	2024	2025	1H25	1H26	YoY
매출	588,039	468,983	464,332	521,439	260,279	287,667	10.5%
반도체	451,799	336,993	331,466	352,409	182,696	205,558	12.5%
IT전자재료	74,037	63,801	78,343	91,622	42,075	53,386	26.9%
2차전지	62,006	67,663	53,812	76,660	35,156	28,341	-19.4%
기타	197	526	711	748	352	381	8.5%
매출원가	464,049	401,426	396,552	420,571	213,774	220,940	3.4%
매출총이익	123,990	67,556	67,780	100,868	46,505	66,727	43.5%
매출총이익률(%)	*21.1%*	*14.4%*	*14.6%*	*19.3%*	*17.9%*	*23.2%*	*29.8%*
판관비	130,704	57,487	64,378	77,107	34,870	41,262	18.3%
영업이익	-6,714	10,069	3,402	23,761	11,635	25,464	118.9%
영업이익률(%)	*-1.1%*	*2.1%*	*0.7%*	*4.6%*	*4.5%*	*8.9%*	*98.0%*
순이익	94,546	-109,458	-79,400	20,159	16,599	19,434	17.1%

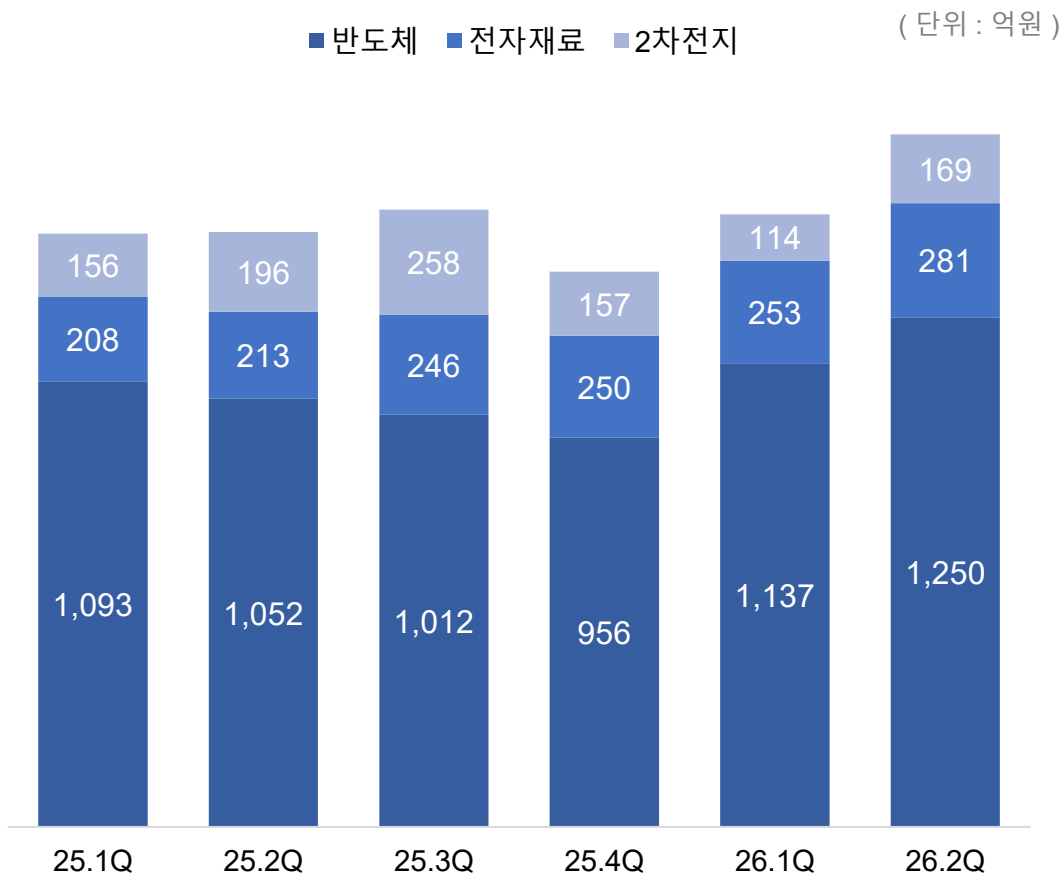
주) K-IFRS 기준

매출 및 영업이익률



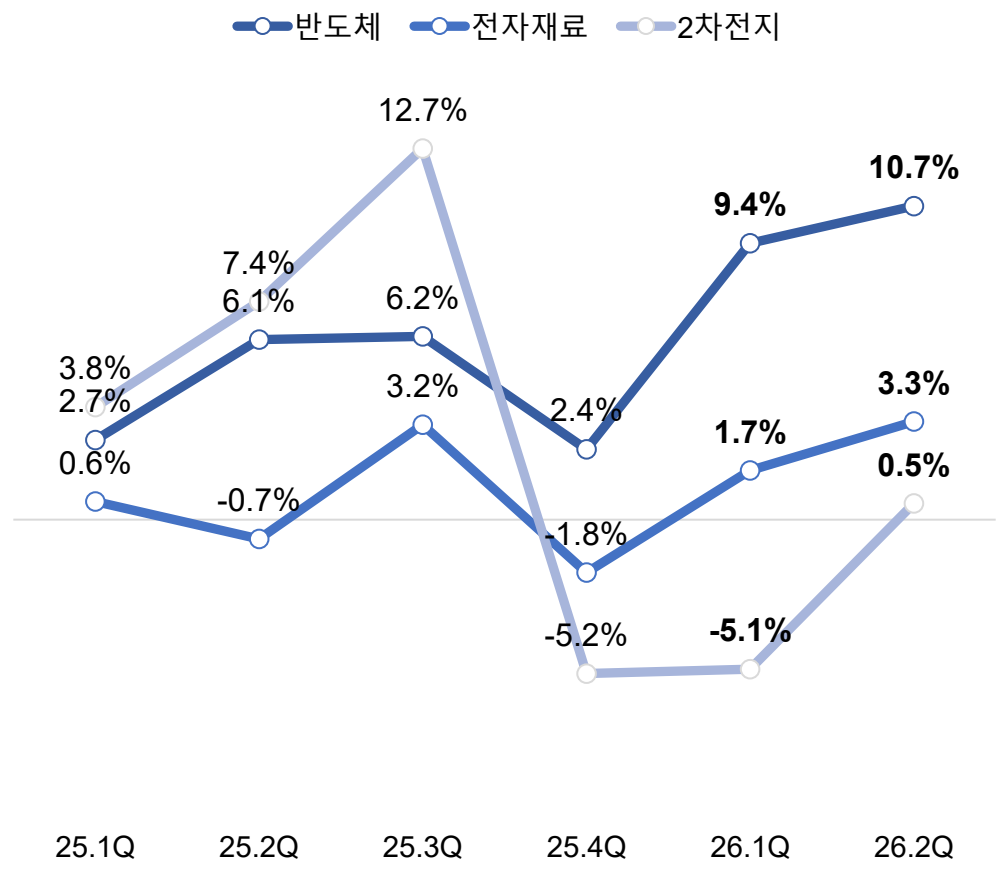
네패스 2Q26 실적(연결)

사업 부문별 매출

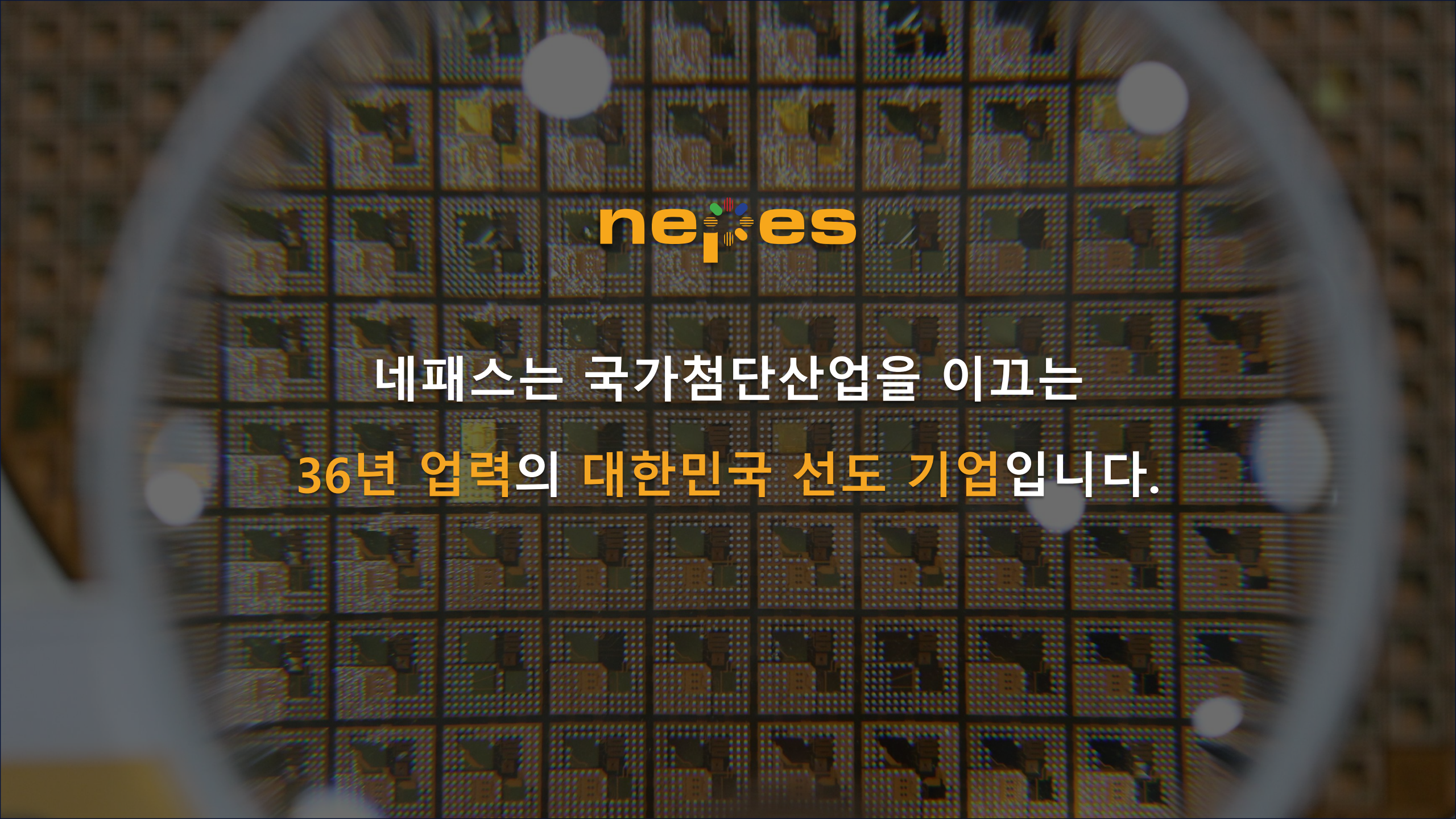


* 조정제외 전

사업 부문별 영업이익률



* 조정제외 전


네패스는 국가첨단산업을 이끄는
36년 업력의 대한민국 선도 기업입니다.



nepes corporation

THANK YOU

To Him who alone does great wonders, His love endures forever. Psalm 136:4
* A dandelion means ‘Gratitude’ in the language of flowers

nepes corporation
2415, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea
Tel : 02-3470-2700
Fax : 02-3470-2708
URL: www.nepes.co.kr